開示の要約

研磨装置および研磨方法

簡単な構造で、基板の膜厚プロファイルを精度よく制御することができる研磨装置が開示される。研磨装置は、基板を保持し、かつ非回転構造を有するステージと、複数の押圧アクチュエータと、パッド保持体と、研磨パッド回転機構と、を備える。

図１